

证券代码：688519

证券简称：南亚新材

公告编号：2024-028

南亚新材料科技股份有限公司关于 投资建设高端电子电路基材基地项目的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：高端电子电路基材基地建设项目；
- 项目实施方式：本项目分为高端 IC 载板材料产业化建设项目及高端覆铜板产业化建设项目
- 投资金额及资金来源：本项目计划总投资额约为人民币 120,000.00 万元（最终项目投资总额以实际投入为准），由公司全资子公司南亚新材料科技（江苏）有限公司（暂命名，最终以工商登记名称为准，以下简称“江苏南亚”）自筹；
- 项目建设周期：本项目建设周期预计为 4 年（最终以实际建设期为准）。
- 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
- 相关风险提示：本项目涉及大额长期资产的投入，在项目投产初期，存在新增折旧摊销费用将导致公司利润下滑的风险，同时，项目实施过程中由于市场本身具有的不确定因素，如果未来业务市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预估产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险，敬请投资者注意投资风险。
- 公司于 2024 年 03 月 25 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设高端电子电路基材基地项目的议案》。前述议案无需提交公司股东大会审议。

一、投资建设项目基本情况

（一）项目概况

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体战略布局及经营发展的需要，为加快产能规划及产业布局，拟投资建设高端电子电路基材基地建设项目，本项目由全资子公司江苏南亚实施，拟在江苏省海门经济技术开发区购置土地建设新的生产基地。该生产基地建成后，将进一步提高公司的产能，以支撑公司高频、高速及 IC 封装材料等高端电子基材未来的产业化需求，从而推动公司业务规模的持续增长，提升公司整体竞争力和盈利能力。

（二）项目基本情况

1、项目名称：高端电子电路基材基地建设项目；

2、项目实施主体：江苏南亚；

3、项目实施地点：本项目拟选址于江苏省海门经济技术开发区，项目占地面积约 217 亩（具体以《国有土地出让合同》为准）；

4、项目投资规模：项目总投资额约为人民币 120,000.00 万元。

5、项目资金来源：由江苏南亚自筹。

6、项目实施方式：本项目分为高端 IC 载板材料产业化建设项目及高端覆铜板产业化建设项目。项目投资估算及营收预测见下表：

单位：人民币万元

项目实施主体	土建投资	设备投资	铺底流动资金	合计
高端 IC 载板材料产业化建设项目	8,800.00	21,200.00	10,000.00	40,000.00
高端覆铜板产业化建设项目	16,800.00	33,200.00	30,000.00	80,000.00
合计				120,000.00

7、项目建设周期：本项目建设周期预计为 4 年。

项目实施主体	建设期（预估）
高端 IC 载板材料产业化建设项目	2024.8-2026.7
高端覆铜板产业化建设项目	2025.8-2028.7

备注：项目建设期系充分考虑项目的重要性及紧迫性，并合理评估资本开支对公司影响后所做出的预估，其中高端覆铜板产业化建设项目拟分批建设。最终以项目实际建设期为准。

（三）项目建设必要性分析

1、符合国家发展战略，巩固公司行业地位

本项目通过建设高端电子电路基材基地，支撑公司高频、高速及 IC 封装材料等高端电子基材未来的产业化需求，进而满足高端电子电路基材生产产线扩产的需求，有利于推动电子材料技术的发展，对于落实国家发展战略规划具有重要意义。此外，本项目将为现有研发成果及新工艺、新产品投入量产提供支撑条件，其有利于提升公司核心竞争力，巩固公司在高端材料行业优势地位。

2、突破现有产线量产瓶颈，提升国产材料竞争力

根据 Prismark 统计，全球 2022 年全球高频高速及 IC 封装材料等特殊覆铜板市场近 44 亿美元，前十大公司占全球营收比例为 84%，仅有一家内资公司生益科技上榜，且市占率仅为 5%。全球特殊材料高端产品市场几乎为境外企业所垄断，特别是 IC 封装材料，几乎为日系及韩系所掌控，内资企业占比不到 3%，且以中低端产品为主。近年来，公司在 IC 封装材料领域通过独立自主及技术许可等方式形成产品并已通过优质客户认证，但现有的产线在功能上并不能很好地支撑 IC 封装材料的量产，亟需新建产线。此外，公司虽然已在高速产品产业化进展顺利，但随着技术迭代，用新建的大产线做新品研发存在巨大原物料浪费及能耗，原有量产较小的产线又不能兼具高端产品中试的功能，亟需建设兼具高端产品样品试制且产能合适的量产新线。

3、有利于公司把握市场需求，抓住市场机遇

纵观电子电路行业的发展历史，虽然行业呈现明显的周期性波动，但整体增长趋势并未发生变化。根据 Prismark 统计及预测，全球 2022 年全球高频高速及 IC 封装材料等特殊覆铜板市场近 44 亿美元，且全球电子系统市场 2022 年约为 24,280 亿美元，到 2027 年将达 29,120 亿美元，年复合增长率将达 3.7%。在人工智能、大数据、智能驾驶、新能源等新兴领域的快速发展拉动下，将充分带动高端电子材料市场需求量的增长。目前公司本次新建项目通过提升公司在高端电子电路基材的产能，可以进一步推动公司业务规模的持续增长，进而提升公司高端材料的市场份额，进而提升盈利能力。

（四）项目建设可行性分析

1、符合国家产业政策，符合市场需求

近年来，国家出台了一系列政策和措施，有力推动了我国电子信息行业的

快速发展，同时人工智能、大数据、智能驾驶、新能源等新兴领域的快速发展，政策推动与市场需求共同为项目实施奠定了基础。

2、公司较强的技术实力为项目实施提供技术保障

公司一直专注于高端电子电路基材的技术研发，自公司成立以来，始终坚持自主研发，产品广泛应用于消费电子、计算机、通讯、汽车电子、航空航天和工业控制等终端领域，目前已形成无铅、无卤、高频高速、车载、高导热、IC 封装、HDI 等一系列核心配方技术，多项核心技术处于国际先进、国内领先水平，公司还构建了省级企业技术中心，CNAS 实验室等研发平台为技术研发提供有利保障。

3、公司优质的客户资源为项目实施提供市场支撑

公司作为覆铜板行业领域的头部企业，凭借深厚的技术储备和丰富的产品类型拓展市场并获得客户认可，积累了稳定的客户资源，为项目实施提供了有力的支撑。本项目公司通过前期工作的开展，全系列各介质损耗等级高速材料已率先通过国内重要通讯设备龙头厂商认证，并实现量产，其中 NY6300、NYP1 材料系国内 AI 算力材料主力供应厂商。IC 封装材料目前国内市占率较低，且国内产品在中高端应用领域几无，公司分别通过自主研发及技术许可等方式开发多款产品，解决关键材料技术难题。目前公司 IC 载板材料在指纹识别、摄像头模块等已在韩国重要终端获得认可；无芯基板用 DCF 材料已获芯爱、兴斐电子、红板等下游客户认可；在 DRAM 应用领域，已完成国内重要半导体龙头企业所需样品开发准备送样。后续公司将进一步巩固深化与现有客户合作，积极开拓新客户，为产能消化提供保障，并将持续加强营销团队建设，打造专业的培训体系、健全人员激励机制，提高公司营销人员的专业技术水平，强化公司营销人员的服务意识，提高公司营销人员的市场推广和开拓能力，从而增强与客户的紧密度及粘性。

4、合理规划产能释放进度，全面提升产品技术性能确保量产

首先，公司在本项目测算时考虑了新增产能的释放过程，由于项目产能存在逐步释放过程，产能消化压力并不会在短期集中出现。此外，鉴于国内终端对高端覆铜板材料国产化的需求不断提升和公司产品竞争力的不断优化，本次项目新增产能可实现逐步消化。

其次，全面提升产品技术性能。公司将进一步推进对高端特殊覆铜板材料

的开发与研究，通过先进的生产技术、完善的工艺流程和优异的产品质量满足客户需求，从而实现产能的消化。在高速材料领域，公司现有产品技术水平将在保持国内领先、国际先进的基础上，在产品关键技术研发方面持续深耕并迭代发展；在 IC 封装材料领域，公司将不断提升产品在优质客户群及应用领域的认证成功率，并全面提升公司生产运营能力以确保量产能力，满足客户需求。

（五）项目与公司主要经营业务的关联度分析

本项目建成后，将在公司原有产品、技术及客户资源的基础上，持续扩大业务规模，特别是进一步提高高端电子电路基材的产能，提高其市场占有率。本项目内容不会改变公司现有主营业务，有益于公司长期可持续发展。

（六）主要风险分析

1、本项目涉及大额长期资产的投入，预计固定资产 80,000 万元，经测算，达产当年新增折旧摊销费用约 6,576 万元。本项目预计的固定资产投资占公司最近一期审计固定资产及在建工程比例为 53.29%，占比较大。在项目投产初期，如果行业或市场环境发生重大不利变化，则项目可能无法实现预期效益，面临新增折旧摊销费用导致公司利润下滑的风险。

2、本项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步等因素密切相关，前述任何因素的变动都可能直接影响项目的经济效益。虽然，公司在项目选择时已进行了充分市场调研及可行性论证评估，但在实际运营过程中，由于市场本身具有的不确定因素，如果未来业务市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在投资项目实施后达不到预期效益的风险。

二、相关审议程序

2024 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会八次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资建设高端电子电路基材基地项目的议案》。

该议案无需提交股东大会审议通过。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。针对本项目实施的进展情况，后续公司将根据相应法律法规要求履行信息披露义务。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2024年3月27日